



東京エレクトロン株式会社

証券コード 8035

株主の皆さまへ

第62期 中間報告書

2024年4月1日から2024年9月30日まで

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

第62期中間期（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の連結業績につきましては、売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも、業績予想を上回る結果を達成することができました。これにより、株主の皆さまへの中間配当金につきましては、2024年8月に発表した予想値に対し28円増額し、1株当たり265円といたしました。

情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、高速・大容量・高信頼性・低消費電力などを実現する半導体の技術革新の重要性が高まっており、当社が事業を展開する半導体製造装置市場はさらなる拡大が見込まれております。

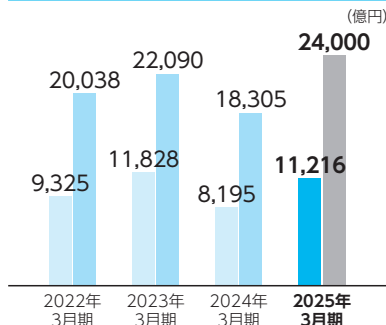
「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念を実践し、今後も中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めてまいります。株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援とご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長・CEO
河合 利樹

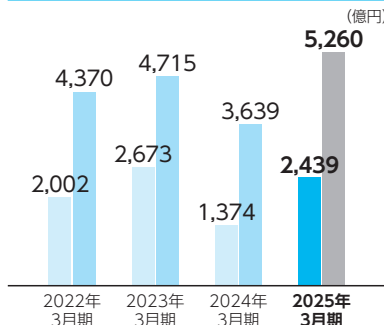
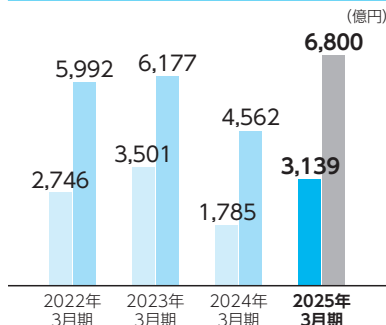
2024年12月



中間期業績ハイライト



■ 中間期 ■ 通期 ■ 当中間期 ■ 通期予想(2024年11月12日公表)



**2025年3月期通期の業績予想を上方修正。市場成長を大きくアウトパフォーム
過去最高の売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を見込む**

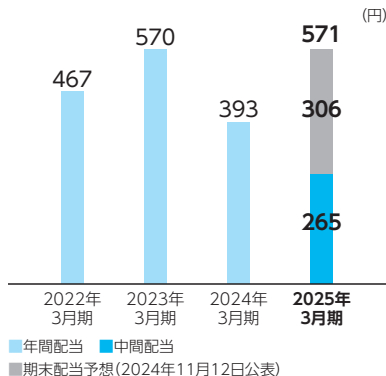
株主還元

中間配当金につきましては、1株当たり265円（支払開始日2024年12月6日）とし、期末配当金は306円を予定しております。

また、2024年5月10日の取締役会決議に基づき、自己株式799億円を取得し、加えて、2024年11月12日の取締役会において、700億円を上限とする自己株式取得を決定いたしました。

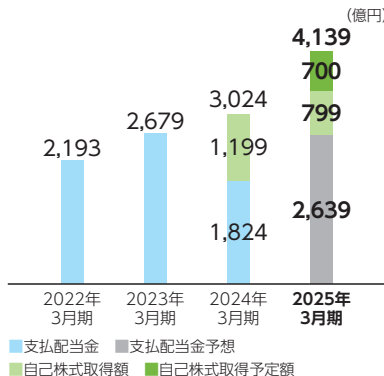
2025年3月期の総還元額は、過去最高水準となる見込みです。

1株当たり配当金の推移



■ 年間配当 ■ 中間配当 ■ 期末配当予想(2024年11月12日公表)

総還元額の推移



■ 支払配当金 ■ 支払配当金予想 ■ 自己株式取得額 ■ 自己株式取得予定額

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。2022年3月期及び2023年3月期の配当金につきましては、2022年3月期の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しております。

中間期トピックス

幅広い製品ラインアップを強みとした事業機会の拡大

当社は、半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセスにおいて、革新的な技術を備えた装置を取り揃えている世界で唯一のメーカーです。これらの装置は各セグメントにおいて世界1位または2位のシェアを獲得しています。加えて、生成AI向け半導体の高性能化に不可欠となる検査・組み立てプロセスにおいても、ウェーハ貼り合わせ装置など、当社のような技術を集結した付加価値の高い製品を提供しています。

足元では、旺盛なAIサーバー向け投資が継続し、AI搭載型PCやスマートフォンの本格普及に向けた先行投資も活発化しており、最先端の技術分野で当社の事業機会は拡大しております。

今後も、技術革新とともに成長する半導体市場において、当社の技術優位性を活かした幅広い製品ラインアップを強みに事業機会を獲得し、さらなる成長を実現してまいります。

最先端技術を備えた新製品のリリース (2024年7月)

お客様のデバイスの微細化や3次元化、成膜材料の多様化のニーズにお応えすべく、枚葉成膜装置のラインアップを拡充し、新たにEpisode™シリーズをリリースしました。

また、EUV露光による最先端のパターニング工程において、さらなる微細化と生産性の向上を実現するため、当社独自の高エッチレートかつ低ダメージのパターン加工技術を備えた、ガスクラスタービーム装置を販売開始しました。

枚葉成膜装置



Episode™ 1



Episode™ 2 DMR
DMR: Duo matched reactor

ガスクラスタービーム装置



Acrevia™

さらなる企業価値向上に向けて (未来に向けた成長投資)

世界の半導体市場は5,300億ドル規模に成長しており、2030年には1兆ドル以上になることが見込まれています。当社では、市場を上回る成長を目指すべく、各分野における成長投資を進めています。2025年3月期より5年間で、研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上、グローバルで累計10,000人の採用を計画しています。

宮城及び熊本の製造開発拠点では新開発棟、岩手では東北生産・物流センターを建設しており、それぞれ2025年に竣工予定です。

今後も技術開発力をさらに強化し、お客様の求める機能を備えた製品をタイムリーに提供することで、中長期における持続的な成長と社会の発展に貢献します。

研究開発投資

1.5兆円



設備投資

7,000億円



人材採用

10,000人
毎年2,000人




株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主 確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人 及び特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
(郵送物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	 0120-782-031
公告方法	電子公告 https://www.tel.co.jp/ir/stocks/koukoku/ ただし、電子公告をすることができない 事故その他やむを得ない事由が生じたとき は、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品 取引所	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード 8035)

■株式に関するお問い合わせについて

単元未満株式の買取請求
住所・氏名のご変更
配当金の受領方法・振込先のご変更 等

- 証券会社に口座をお持ちの株主さま
お取引証券会社にお問い合わせください。
- 証券会社に口座をお持ちでない株主さま
(特別口座をお持ちの株主さま)
三井住友信託銀行 証券代行部
 0120-782-031
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)

■未払配当金に関するご照会

三井住友信託銀行 証券代行部

■株主総会資料の電子提供制度について

会社法改正により、株主総会資料は原則としてウェブサイトでのご提供となりました。

2025年6月の当社定時株主総会において、新たに書面でのお受け取りをご希望される株主さまは、2025年3月31日までに、お取引証券会社または株主名簿管理人である三井住友信託銀行を通じて、「書面交付請求」のお手続きをおこなっていただきますようお願いいたします。